

BOE (京东方) 2017年校园招聘职位列表 (技术研发类)

序号	职位名称	岗位职责	任职资格
1	技术战略规划	1、调研行业发展状况,进行行业分析、产品分析和技术发展趋势分析,进行全球资源搜集,判断关键技术和颠覆性技术,完成行业分析报告; 2、结合集团战略与内部资源情况,判断未来集团技术发展重点方向,并细化各方向中长期和阶段性技术指标,完成技术roadmap; 3、分析新技术发展趋势和市场、客户需求,提出可行的技术方案,策划重点项目。	1、博士学位,人工智能、计算机、电子工程、信息工程、通讯技术、自动化等相关专业; 2、具备优秀的表达能力,协调能力,沟通组织能力和逻辑推断能力; 3、工作态度积极,责任意识和学习能力强,能承受高强度工作负荷。
2	全球技术战略合作	1、与集团研究院及业务部门配合,分析新技术发展趋势和市场前景,根据集团技术或业务发展需要提出合作方案,策划重点项目; 2、与专业投资机构,行业领先公司建立合作网络,发掘热点项目,为集团技术或业务投资进行寻源; 3、与国内国际领先高校实验室建立深度合作关系,领导集团创新项目的共同开发。	1、博士学位,人工智能、计算机、电子工程、信息工程、通讯技术、自动化等相关专业; 2、对人工智能或健康医疗领域有自己的思考和见解; 3、具备优秀的逻辑表达能力和沟通协调能力; 4、工作态度积极,有责任心;英语水平良好,学习能力强,乐于不断学习新事物。
3	硬件开发	1、负责ARM、MCU、DSP等嵌入式产品开发,负责FPGA产品的设计验证,包括产品定义、架构设计、代码设计、开发调试、测试验证; 2、负责模拟数字电路相关的产品设计,硬件原理设计、PCB Layout和硬件调试电路调试、支持和维; 3、负责光学相关的产品设计、光路设计、仿真、集成和测试; 4、负责移动健康相关的产品设计,负责体征传感器设计、集成和测试。	1、博士学位,计算机、电子、人工智能、图像、通信、自动化、光学、光电子、生物医学工程、仪器仪表等相关专业; 2、有较好的英语能力(英语六级及以上); 3、善于沟通,有较强的学习能力、逻辑分析能力、动手能力和执行力; 4、良好的团队合作精神、沟通协调能力和抗压能力。
4	软件开发	1、负责物联网与人工智能相关的前瞻性软件研发,相关技术分析、路径规划和项目选题; 2、负责Android/Linux相关系统软件开发,含驱动、中间件和应用开发; 3、负责人工智能(含人机交互)相关图像处理、自然语言处理等算法开发; 4、负责物联网/医疗大数据方向的技术分析、研发; 5、负责物联网相关服务器端、云端相关应用软件开发。	1、博士学位,计算机、电子、通信、数学、生物医学、自动化等相关专业; 2、精通C/C++、Java、Android、数据库和网络通信、物联网与人工智能产品软件; 3、有较好的英语能力(英语六级及以上); 4、善于沟通,有较强的学习能力、逻辑分析能力、动手能力和执行力; 5、良好的团队合作精神、沟通协调能力和抗压能力。

BOE (京东方) 2017年校园招聘职位列表 (技术研发类)

序号	职位名称	岗位职责	任职资格
5	专利标准融合	<ol style="list-style-type: none"> 负责跟踪物联网领域标准组织进展； 研究物联网领域相关标准，完成高质量的研究报告和专利； 参加物联网领域标准会议研讨。 	<ol style="list-style-type: none"> 博士学位，计算机、通信、电子、自动化等理工类专业，有标准研究、标准协议开发经验者优先； 有较好的英语能力（英语六级及以上），海外留学经历者优先； 善于沟通，有较强的学习能力、逻辑分析能力、动手能力和执行力； 良好的团队合作精神、沟通协调能力和抗压能力。
6	无机半导体器件研发	<ol style="list-style-type: none"> 负责传统半导体器件的开发优化以及基于新型半导体材料的器件研发； 牵头薄膜传感器件、其他新型薄膜器件的设计及工艺开发； 调研业界新型无机半导体器件研发动态，设计创新性的器件方案； 负责新型无机半导体器件原理分析，结构设计优化，材料筛选，模拟仿真等工作； 负责有机半导体器件的结构设计、仿真和器件性能优化。 	<ol style="list-style-type: none"> 博士学位，半导体，光电子，物理等相关专业； 具备半导体器件开发经验； 具备英文文献的读写能力，和较强的创新能力、学习能力、逻辑分析能力、动手能力与执行力； 良好的团队合作精神、沟通协调能力和抗压能力。
7	无机半导体工艺研发	<ol style="list-style-type: none"> 负责半导体工艺的开发和优化，参与基于新型无机半导体器件的研发； 支持对于新型半导体器件的工艺开发； 精研CVD/Sputter/Photo/Etch等工艺优化； 跟踪业界最先进的无机半导体加工设备及工艺，负责调研并开发新型半导体工艺，以及相应的检测表征手段； 其他设备改造或购置，新材料及新工艺导入等。 	<ol style="list-style-type: none"> 博士学位，半导体，光电子，物理等相关专业； 具备Array背板的工艺开发经验； 具备英文文献的读写能力，和较强的创新能力、学习能力、逻辑分析能力、动手能力与执行力； 良好的团队合作精神、沟通协调能力和抗压能力。
8	器件集成设计研发	<ol style="list-style-type: none"> 负责显示及非显示器件架构开发评估、背板电路、仿真、驱动设计与版图设计； 前沿器件在玻璃基板上集成可行性研究与新应用开发； 协助相关部门机理性验证设计与整体性问题分析； 设计文件制作、管理及流程完善。 	<ol style="list-style-type: none"> 博士学位，固体物理、半导体物理、微电子等相关专业； 具备英文文献的读写能力，和较强的创新能力、学习能力、逻辑分析能力、动手能力与执行力； 良好的团队合作精神、沟通协调能力和抗压能力。

备注：以上职位工作地点均为北京亦庄